Gallium indium nitride light emitting device mfr. - where beryllium sulphide, zinc oxide, boron phosphide or gallium nitride layer is deposited on substrate

Patent Assignee: SUMITOMO ELECTRIC IND CO

Patent Family (2 patents, 1 country)							
Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Update	Type
JP 1980003834	В	19800126	JP 197220053	A	19720226	198008	В
JP 49019782	A	19740221				198008	E

Alerting Abstract: JP B

BeS, ZnO, BP or GaN layer is deposited on a quartz substrate, an SnO2-coated quartz substrate, a BP(111)substrate, a BAs(111)substrate, a GaP(111)substrate, an alpha-SiC (0001) substrate, SnO (0001) substrate, or sapphire (0001) substrate. An active layer of Ga1-xInxN mixed crystal is formed on the deposited layer.

International Classification (Additional/Secondary): H01L-021/20, H01L-033/00

Original Publication Data by Authority

Japan

Publication Number: JP 49019782 A (Update 198008 E)

Publication Date: 19740221

Language: JA|JP 1980003834 B (Update 198008 B)

Publication Date: 19800126

Assignee: SUMITOMO ELECTRIC IND CO (SUME)

Language: JA

Application: JP 197220053 A 19720226 Original IPC: H01L-21/20 H01L-33/00 Current IPC: H01L-21/20 H01L-33/00

Derwent World Patents Index

© 2007 Derwent Information Ltd. All rights reserved. Dialog® File Number 351 Accession Number 1909230

郵 (B2) 特 許 公 昭55-3834

(1) Int.Cl.3

識別記号

庁内整理番号

244公告 昭和55年(1980) 1月26日

H 01 L 33/00

7377-5F 7739-5F

発明の数 2

(全5頁)

I

匈Ga_{1-X}In_XN 発光素子の製法

21)特 願 昭47-20053

22出 願 昭47(1972)2月26日

公 開 昭49-19782

43昭49(1974)2月21日

者 新宮秀夫 ⑫発 明

京都市左京区松ケ崎小脇町 28

徊発 明 者 大槻徴

祥風荘

⑩発 明 者 長村光造

京都市右京区嵯峨野秋街道町 16

者 赤井慎一 720発 明

電気工業株式会社大阪製作所内

们出 願 人 住友電気工業株式会社 大阪市東区北浜5の15

個代 理 人 弁理士 上代哲司

69引用文献

米国特許 3560275 (USA) (クラス 148-171)

電子材料 昭 46.12 第 21 ~ 29 頁

Applied Physics Letters 9(12) 1966. 12.15 第441~444頁

の特許請求の範囲

1 石英ガラス基板、SnO2をコーテイングした 石英ガラス基板、Bp111基板、BAs111 基板、GaP111基板、α-SiC0001基 面上に成長させたBeS,ZnO,Bp、又は GaNの成長層から成る基板、およびBeS若し くはBeSeから成るグループから選ばれた一種 の基板上に、動作層としてGa1-xInxN混晶の 層を気相成長せしめることを特徴とするGa_{1-x} 35 InxN発光素子の製法。

2 p型のBp若しくはBAs又は高抵抗のBeS

若しくはBeSeから成る基板上に動作層としてn 型Gai-xInxN混晶の層を気相成長せしめるこ とを特徴とするGaiーxInxN発光素子の製法。 但し、xは0と1の間の値である。

2

5 発明の詳細な説明

本発明はGaNとInNの混晶、すなわちGai -x I n xN (o < x < 1) を用いた可視光発光素子 に関するものである。

Ⅱ-Ⅴ族化合物半導体を用いた発光素子として 京都市左京区田中東春菜町23の1 10 はGaAs_{1-x}P_x(0 < x < 1)、Ga_{1-x}Aℓ_x As (0 < x < 1), $Ga_{1-x} In_{x} P(0 < x < 1)$, GaP, $Ga_{1-x}A\ell_{x}P(0 < x < 1)$, In_{1-x} AℓxP(0 < x < 1) 等を用いた発光素子がある が、いずれも赤色、黄色、黄緑色の発光素子しか 大阪市此花区恩貴島南之町60住友 15 得られていない。又深緑色から青色(又は紫色) の発光素子としては GaNを用いた発光素子が提 案されている。しかしながらGaNの禁制帯幅は 300°Kで3.39eVもあり、光でいえば紫外 光に相当する。従つて GaN を用いて可視光を得 20 るには適当な不純物準位を介する電子の遷移を用 いることが不可欠となる。この場合、適当な不純 物が存在するかどうかは明らかでなかつた。

> 本発明はGa_{1-x}In_xN(0<x< 1) の均一 な混晶が形成され得ることを明らかにするととも 25 に、Ga_{1-x}In_xNを用いた優れた可視光発光素 子の製法を提供するものである。

本発明の第1の発明は、電気的にバイアスをか けたときに可視光を発する発光素子の製法におい て、適切な基板上に動作層としてGa_{1-x}In_xN 板、Zn00001基板およびサフアイヤ 00 01 30 混晶の層を気相成長せしめることを特徴としてい る。ここで、Ga1-xInxN混晶の層をpn接合 を含む闇とすることができる。又 n 型Ga_{1-x}Inx N混晶の層を含む Min 構造をもつ層を動作層と することが出来る。

> 但しMは金属、iは高抵抗Gal-xInxN又は 絶縁物の層を意味する。

本発明において、適切な基板としては、石英ガ

· 3

ラス基板、SnO2をコーテイングした石英ガラス 基板、BP111基板、BAs111基板、α-SiC0001基板、ZnO0001基板、又は サフアイヤ0001面上に成長させたBeS, ZnO, BP若しくはGaNの成長層から成る基板から選択 5 Gao.4Ino.6N(Zn)では2 eV以下のエネルギ することができる。

更に、n型Ga1-xInxNとのヘテロ接合を pn接合として活用するために、適切な基板とし てp型のBP若しくはBAsを用いたり、又、髙 抵抗のBeS若しくはBeSeを基板としてn型 Ga1-xInxNとのni接合を利用することがで

以下本発明を実施例により説明する。

実施例 1:

させて、石英ガラス基板上にGa1-xInxNの層 を成長させたものである。 GaN と InN の割合 を変化させることによつてxの値が変化させられ た。成長したGa_{1-x}In_xNの層はウルツ鉱型の 結晶構造をもち、石英ガラス基板の面に垂直な方 20 実施例 2: 向に、結晶の<0001>方向が配向する傾向が あつた。この成長のメカニズムはいわゆるレオタ キシャル成長によるものと考えられる。

 $Ga_{1}=xIn_{x}N$ の層の厚さは5~10 μ であつ た。

次にX線回折により結晶の格子定数を測定し、 又光の吸収を測定することにより直接型の禁制帯 幅を測定した。

第1図はその測定結果をまとめたものである。 を、縦軸に禁制帯幅 Eg(eV) と格子定数 a(Ă)お よび c(A)とを示す。

X線回折の実験により、Ga_{1-x}In_xN混晶の - 均一な層が成長していることが分つた。又光の吸 収の実験からGa_{1-x}In_xN混晶が直接遷移型の 35 半導体であることが分つた。

第1図から明らかなようなGa_{1-x}In_xN混晶 においては、格子定数がxとともに直線的に変化 し、いわゆるヴェガードの法則が成立することが 呈し、 CaN と InNのEgを単純に直線で引い たのではGa1-xInxN混晶のEgの値を推定で きないことを意味している。

次にZn,Cd,Mg,Be,Ge,Cuの様な不純物

をドープすると禁制帯幅に相当するエネルギーの 他に別の吸収帯が観測される。第1図の区印は ZnをドープしたGa_{1-x}In_xN混晶に観測され る附加的な光吸収のエネルギーを示す。例えば 一の吸収が見られ、これは赤色発光用材料として も有用なことを示している。

もし乙n,Cdなどの不純物をドープしないとき は、石英ガラス基板上に成長させたGai-xInxN 10 混晶は n 型半導体であり、3 0 0°Kで 1~1000 ohm·cmの比電気抵抗を示す。第2図は比較的高 抵抗のn型Ga_{1-x}InxN混晶の層に電極を設け た実験を示すもので、図において、1は石英ガラ ス基板、2はGa_{1-x}In_xNの層、3はIn の蒸 本実施例は、GaN結晶とInN結晶とを昇華 15 着膜、4は Au の微小電極である。電極4を正に バイアスしたとき、電極4の近傍で弱い発光が認 められた。(図でh v として発光を示す)。発光 強度は弱いけれども例えば Gao.e Ino.4 N で 青色 の発光が観測されたことは興味深い。

本実施例はSnO2の導電層をコーティングした 石英ガラス基板上に Ga_{lーx} In_xNの層を成長さ せたものである。

第3図は本実施例により作成された発光ダイオ 25 ードの構造を示し、1は石英板、5は導電層、2 はGa₁-xInxNの層でn型半導体である。3と 4は電極である。

6 は活性窒素中で2nを拡散させたp型 Gaıー xInxNの層であるn型Ga1-xInxNの層2の 図は横軸にGa_{1-x}In_xN中のInNのモル比x 30 厚さは5~10 μ、p型Ga_{1-x}In_xNの層6の 厚さは $1\sim 2\mu$ であり、p層6の比電気抵抗は 10³~10⁶ ohm—cm であつた。電極 4 をプラス にしてバイアスを加えた所、層6から肉眼ではつ きり認められる発光が観測された。

> 発光色は x の大きい所(x ~ 0.6) で赤から黄 色 x の小さい所(x≤0.3)で黄緑から深緑色に わたつていた。

実施例 3:

本実施例では単結晶基板が用いられた。 BP, 分る。一方禁制帯幅 Egはxに対し凹型の曲線を 40 BAsの111面、GaPの111面、αーSiC の0001面、 ZnOの0001面等が用いられ た。又サフアイヤ (Al₂O₃)上にエピタキシャ ル成長させたBeS,ZnO,BP,GaN 等を基板と して、更にその上にGa1-xInxNの層を成長さ

5

せることも可能である。

第4図はこの様なGa_{1-x}In_xNの層の一例で あり、7はサフアイヤの0001面をもつ基板、 8はn型の ZnO のエピタキシャル層、そして2 はn型のGa_{1-x}InxNのエピタキシャル層であった。レーザー作用を有する高効率発光素子も可能とな

このウェハに更に高抵抗の Gai-x In x N 又は p型のGa1-xInxNを成長させれば、容易にい ろいろな発光素子用材料が得られる。その構造の 1 例を第5図に示す。第3図、第4図と同一符号 10 N混晶の層を気相成長せしめることを可能にする は同じものを示す。第5図で電極3,4の間にバ イアスをかければ、高抵抗又はp型のGa1-xInx Nの層6の部分で発光が観測される。この場合、 層2の中のxの値よりも層6の中のxの値を小さ くすることによつて、外部へ光を取り出し易くす 15 子の分野の発展に寄与するものである。 ることも可能である。

以上の実施例では、発光に寄与する動作層が Gal-xInxN混晶の層そのものである場合につ いて説明したが、他の半導体とのヘテロ接合を含 む層を動作層とする発光素子を作ることもできる。20 図で、第4図は第5図に示す発光素子に用いられ 例えばp型のBPやBAs 又は高抵抗のBeSe と、n型のGa1-xInxNとのヘテロ接合を用い れば格子定数の不適合の少い発光素子が得られる。 この様な構造の発光素子は特に深緑から青色(又 は紫色)にまたがる可視光の発光素子として有用 25 7はサファイヤ単結晶基板、8は ZnO のエピタ である。更に複数個の発光素子を用いることによ

り、数字や文字等の表示装置を形成することが出 来る。

又Gal-xInxN混晶を用いた発光素子の効率 が向上すれば、緑色から青色(又は紫色)までの るであろう。

以上述べた如く、本発明は、電気的にバイアス をかけたときに可視光を発する発光素子の製法に おいて、適切な基板上に動作層としてGa1-xInx もので、従来のGaP, GaAs_{1-x}Px, In₁-x AℓxPなどの半導体では得られなかつた深緑色か ら青色の発光素子の製作を可能にし、深緑色から **青色までの各種表示素子を含む新しい光半導体素**

図面の簡単な説明

第1図はGa_{1-x}In_xN(0<x<1)混晶の 禁制帯幅と、格子定数の変化を示す図で、第2図、 第3図および第5図は本発明の実施例を示す断面 たGai_vIn xN の層を示す図である。

図において、1は石英基板、2はn型Gai-x InxNの層、3は陰極、4は陽極、5は透明な導 電層、6は高抵抗又はp型のGai-xInxNの層、 キシャル層である。

第1図



